



# 銅に均一メツキ皮膜

**基板 奥野製薬が触媒付与液**

奥野製薬工業（大阪市中央区、奥野和義社長）は、銅の配線や回路の腐食を防ぎ、表面

に均一なメッキ皮膜を形成する触媒付与液「ICPアクセラCO」を開発した。従来

A」を開発した。従来のパラジウム触媒ではなくコバルト触媒を付与することにより、均一で被覆性に優れた無電解メッキ皮膜を得られる。すでにプリント

基板メーカーにサンプル出荷を始めた。

ICPアクセラCOはコバルト触媒を還元析出し、銅表面に均一な触媒膜を形成す

る。ニッケルと金、パラジウムと金といった各種無電解メッキ処理に対応する。従来の触

媒付与液はパラジウム

と

ICPアクセラCO

Aは表面に均一なメッキ皮膜を形成する

ボイドが発生していった

（矢印部分）

触媒を置換析出する隙間（ボイド）が発生し

が、銅が過剰に溶解し品質不良の原因となる

性が低下し、基板と電

子部品をつなぐハンダ

やワイヤボンディング

の接合信頼性に影響す

る」と懸念されてきた。

プリント配線板に

は、絶縁板上に銅の配

線や回路を施し、ハン

ダ接合やワイヤボンデ

触媒を形成し無電解メッキを施す必要がある。ICPアクセラCOはコバルト触媒を還元析出し、銅表面に均一な触媒膜を形成す

る。ICPアクセラCOは均一な無電解メッキ皮膜の形成に寄与し電子部品を実装する上で、ハンダ接合に伴う銅回路の酸化を抑制しワイ

ヤに用いる金属を結合するため、銅の表面に

部品を実装する上で、ハンダ接合に伴う銅回

路の酸化を抑制しワイ

ヤに用いる金属を結合するため、銅の表面に

部品を実装する上で、ハンダ接合に伴う銅回

路の酸化を抑制しワイ

ヤに用いる金属を結合するため、銅の表面に

部品を実装する上で、ハンダ接合に伴う銅回

路の酸化を抑制しワイ

ングによって電子部

OAは均一な無電解

メッキ皮膜の形成に寄与

し電子部品の接合品質

を確保できる。

奥野製薬工業は表面

処理薬品を製造販売

し、無電解メッキ液や

プリント配線用処理薬

品など約2700種類

の薬品を手がける。